

半导体多芯片堆叠大尺寸封装基板产品制造项目厂房建设项目施工监理定标报告

一、项目概况

1、项目名称：半导体多芯片堆叠大尺寸封装基板产品制造项目厂房建设项目施工监理

2、项目建设地点：广州市黄埔区九龙镇知新路 1321 号。

3、建设规模：本项目建设地点位于广州黄埔区中新知识城，总投资 3.8 亿元，均为基建投资。项目将建设封装基板专业工厂厂房 1 栋以及配套建筑 1 栋，用于生产半导体多芯片堆叠大尺寸封装基板产品。本项目占地面积约 26050 平方米，总建筑面积约 104200 平方米。本项目最大单项工程建筑面积为 7.2704 万平方米。

4、招标单位：广州广芯封装基板有限公司

5、招标代理：建成工程咨询股份有限公司

6、招标方式：公开招标

7、资金来源：企业自筹资金

8、最高投标限价总价：188 万元。

二、定标前期准备工作：无。

三、定标委员会组建情况

定标会在 2025 年 12 月 23 日 14 时 00 分至 18 时 00 分在广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）黄埔交易部第 4 评标室进行。定标由招标人依法组建的定标委员会负责，成员数量为 5 人。具体名单如下：

定标委员会组长：_____，

定标委员会成员：_____

四、评标情况

评标会在 2025 年 12 月 16 日在广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）增城交易部第 2 评标室进行，评标委员会按招标文件的评标办法对投标文件进行评审。

评标办法：采用“评定分离的评标及定标办法”，通过完成初步评审（形式评审、资格评审、响应性评审）的全部投标人进入定标环节。

经评审，评标委员会按照招标文件的规定推荐合格的中标候选人【不排序，按统一社会信用代码后 4 位（除校验码外）大小排位，如统一社会信用代码后 4 位出现字母情

况的，字母以“0”进行代替大小排位；如出现后4位（除校验码外）大小一致的，则随机排位】。名单如下：

统一社会信用代码	合格的中标候选人	投标报价（元）
91440000190336153B	广东工程建设监理有限公司	1650000.00
91440000721197608E	公诚管理咨询有限公司	1410000.00
91440106231219552K	广州万安建设监理有限公司	1619620.00

五、定标情况

定标办法：次定标采用“价格因素”+“方案因素”+“答辩因素”，其中总得分（100分）=价格因素得分（40分）+方案因素得分（30分）+答辩因素得分30分。据定标因素（详见《定标因素表》）对各合格中标候选人进行综合评审，总分由高至低排序，综合得分最高的确定为中标人。

投票规则：由定标委员会进行综合评审，经评审，定标委员会向招标人推荐得分高的合格中标候选人为中标人，若合格中标候选人总得分相同且影响定标排序的，以价格因素得分高的排前；若价格因素得分仍相同的，以方案因素得分高的排前，若方案因素得分仍相同的，以答辩因素得分高的排前；若答辩因素得分仍相同的，由定标委员会采用记名投票方式确定排序。

经评审，各合格中标候选人的得分详见《定标阶段评审得分表一定标委员会个人用表》、《定标阶段评审得分表一定标委员会汇总用表》、《中标人确定表》。结果如下：

序号	合格中标候选人	总得分	排名	是否被确认为中标人
1	广东工程建设监理有限公司	79.66	2	否
2	公诚管理咨询有限公司	86.83	1	是
3	广州万安建设监理有限公司	77.28	3	否

六、定标结果

定标委员会根据招标文件规定的定标原则确定中标人，定标结果如下：

中标人名称	中标价（元）
-------	--------

公诚管理咨询有限公司	1410000.00 元
------------	--------------

七、澄清事项纪要：无。

八、定标过程中澄清、说明、补正事项纪要：无。

特此报告。

定标委员会全体成员签字：

2025 年 12 月 23 日